

技术参数

5216

日期 : 01/2020
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款单组份加热固化胶黏剂，粘度适中易流平，对多种材料附着力好固化速度快，适用于电子领域元器件粘接保护，尤其使用于金线及焊线粘接固定，具有较好的抗震耐湿热性能
金属，塑料 PCB，玻璃，陶瓷等
电子器件芯片金线保护固定

粘接材料 典型应用

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色液体	
粘度(cps)	24030	10rpm@25°C, ASTM D-1084
TI	2.33	
固化条件	85°C/40m 或 150°C/10m	
有效期@ -20°C,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	85D	ASTM D-2240
TG	119°C	DSC,TAQ20, 40°C/Min
热膨胀系数(ppm/°C)	a1=29 a2=108	

储存和使用方法

产品在低于-20 度冷冻环境中储存；使用前需回温解冻处理，解冻过程建议缓慢，30ml 包装需要 2 小时及以上回温；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

www.stick1mat.com
Email: info@stick1mat.com
上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

